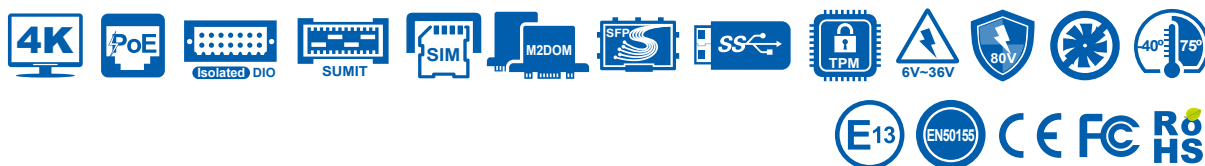
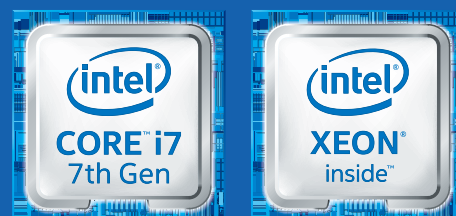


LAN×最大9基(うちPoE×最大4基/SFP×最大2基)、第7世代Core™ / Xeon® E3プロセッサ搭載

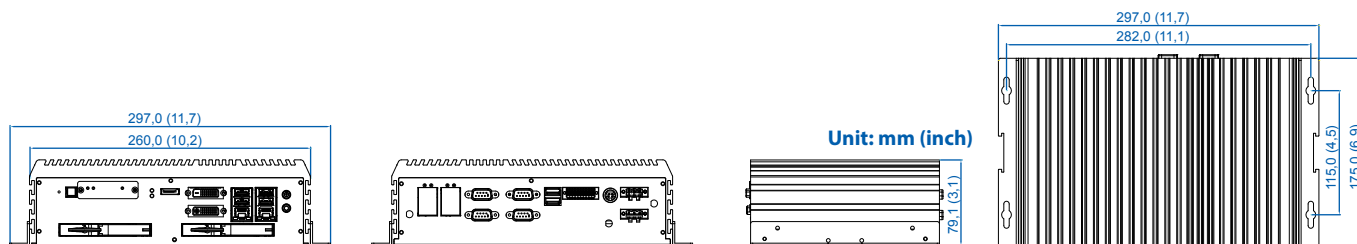
# ECS-9000 Series



- 第7世代/第6世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリー搭載  
または、インテル® Xeon® プロセッサE3-1200 v6/v5を選択
- インテル® C236チップセット装備
- 最大-40°C~+75°Cの広温度対応
- USB3.0ポート×6基、COMポート×4基装備
- 最大9基のGbEポートを装備し、うちPoE+ポート最大4基  
／10GbE SFP+最大2基装備
- 6V-36V DC-in、80Vまでをサージ防護
- 絶縁型16 DIO (8 DI, 8 DO) 装備  
※対象はECS-9000-9R、9GD、PoER、PoE。それ以外のモデルは16 GPIOになります



## ■ 外観寸法



## ■ 製品仕様

プロセッサ	種類	第7世代/第6世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリー インテル® Xeon® プロセッサ-E3-1200 v6/v5
	搭載数	1
チップセット		インテル® C236 チップセット
メモリー	規格	DDR4 2133MHz SO-DIMM
	容量	最大32GB
	スロット数	2
ストレージ	CFastソケット	1
	2.5" SSD/HDD	ECS-9000-9R, PoER, 6FR, 4R, 2R : フロントアクセス(2.5" SSD/HDDトレイ)×2 ECS-9000-9GD, PoE, 6F, 4G, 2G : 内部(2.5" SSD/HDDブラケット)×2
	M2DOMソケット	1
SIMカードソケット		3
グラフィックス		インテル® HD グラフィックス 630/530
I/O	シリアル(COM)	4
	USB	前面 4 (USB3.0) / 背面 2 (USB3.0)
	DIO	絶縁型16 (8 DI, 8 DO) ※対象はECS-9000-9R, 9GD, PoER, PoE。それ以外のモデルは16 GPIOになります
	DisplayPort	1 (最大4096 × 2304 @ 60Hz)
	DVI-I	1 (最大1920 × 1200 @ 60Hz)
	DVI-D	1 (最大1920 × 1200 @ 60Hz)
	Ethernet	LAN 1 : インテル® I219LM GigE LAN, iAMT 11.0 LAN 2 : インテル® I210 GigE LAN LAN 7~9 : インテル® 82574L GigE LAN ※ECS-9000-9R, 9GDのみ
	PoE	LAN 3~6 : GigE IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+, インテル® I210 ※ECS-9000-9R, 9GD, PoER, PoE
	10G Ethernet SFP+	LAN 6 : インテル® 1000BASE SFP+, インテル® I350 LAN 7 : インテル® SFP+, インテル® I350 ※ECS-9000-6FR, 6F
	拡張スロット	Mini PCI Express
オーディオ		コーデック: Realtek ALC892, 5.1 Channel HD Audio 端子: 1 Mic-in, 1 Line-out
電源	入力電圧	6V~36V, DC-in
	電源入力タイプ	3-pin Terminal Block : V+, V-, Frame Ground Mini-DIN 4-pin
	イグニッションコントロール	16 Mode (内部)
	リモートスイッチ	3-pin Terminal Block : On, Off, IGN
	サージ保護	過渡電圧: 最大80V/1ms
外観寸法 (W × L × H)		260mm × 175mm × 79mm (突起物等を除く)
重量		約3.8kg
取付方法		ウォールマウント用ブラケット, DIN レール (オプション)
利用環境	動作温度	35W TDP CPU : Core™ i7 : -40°C ~ +75°C, Xeon® E3-1268L v5 : -40°C ~ +70°C 65W TDP CPU : Core™ i7 : -40°C ~ +55°C 80W TDP CPU : Xeon® E3-1275 v6, E3-1275 v5, E3-1225 v5 : -40°C ~ +45°C
	保存温度	-40°C ~ +85°C
	湿度	5%~95% RH (結露なきこと)
	耐衝撃性	IEC 60068-2-27, SSD : 50G @ wallmount, Half-sine, 11ms
	耐振動性	IEC 60068-2-64, SSD : 5Grms, 5Hz~500Hz, 3 Axis
EMC指令		E13, CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2



HPCシステムズ株式会社 CTO事業部  
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階  
TEL : 03-5446-5535 / hpcs\_sales@hpc.co.jp

embe.hpc.co.jp

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel, インテル, Intel ロゴ, Intel Inside, Intel Inside ロゴ, Centrino, Centrino Inside, Intel Viiv, Intel Viiv ロゴ, Intel vPro, Intel vPro ロゴ, Celeron, Celeron Inside, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Core Inside, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, Viiv Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。AMD, AMD Radeon™, Radeon™ は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。  
2019年5月28日現在の内容です。